

Title (en)

High-melting electrical conductive connection and method of manufacturing

Title (de)

Hochschmelzende elektrisch leitende Verbindung und Verfahren zu deren Herstellung

Title (fr)

Connexion électriquement conductrice à haut point de fusion et procédé de fabrication

Publication

**EP 0831565 A1 19980325 (DE)**

Application

**EP 97109917 A 19970618**

Priority

DE 19638209 A 19960919

Abstract (en)

The electric connection contacts a contact point (12) with a contact member (14). Between the contact point (12) and the contact member (14) is a diffusion active layer (19) of a palladium-nickel alloy. The diffusion active layer (19) may be formed on the contact member. The layer (19) is preferably between 2 and 20 micrometers. In the method of making the connection, the diffusion layer (19) is attached to the contact member. The contact member (14) is positioned on the contact point (12). Then under the effect of a pressing force the contact member at least in the region of the contact point is heated to a diffusion solder or welding temperature.

Abstract (de)

Es wird eine elektrisch leitende Verbindung sowie ein Verfahren zu deren Herstellung vorgeschlagen, wobei eine Kontaktstelle (12) mit einem metallischen Kontaktteil (14) kontaktiert wird. Das Kontaktteil (14) ist zumindest im Bereich der Kontaktstelle (12) mit einer diffusionsaktiven Schicht (19) aus einer Palladium-Nickel-Legierung versehen. Die elektrisch leitende Verbindung wird durch Diffusionslöten bei einer Fügetemperatur von 750 bis 950° C je nach Pd/Ni-Legierung erzeugt. <IMAGE>

IPC 1-7

**H01R 43/02**

IPC 8 full level

**B23K 20/16** (2006.01); **B23K 35/00** (2006.01); **B23K 35/32** (2006.01); **H01L 21/48** (2006.01); **H01R 43/02** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B23K 20/16** (2013.01); **B23K 35/007** (2013.01); **B23K 35/322** (2013.01); **H01L 21/4853** (2013.01); **H01R 43/0214** (2013.01); **B23K 35/004** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] DE 3639983 A1 19880601 - DORNIER GMBH [DE]
- [DA] WO 9518777 A1 19950713 - ROTH TECHNIK GMBH [DE], et al

Cited by

EP1246305A3; DE10104414A1; AU2001248398B2; US6717065B2; US6974615B2; US6772936B2; US6818839B2; WO0171852A1

Designated contracting state (EPC)

AT DE ES FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0831565 A1 19980325**; DE 19638209 A1 19980326

DOCDB simple family (application)

**EP 97109917 A 19970618**; DE 19638209 A 19960919